

特点:

- 低损耗: 典型值 3.0dB
- 高阻带抑制:
最小值 50dB @ $f_0 \pm 100\text{MHz}$
- 良好的带内驻波比: 典型值 1.5:1
- SMT 封装
- 封装尺寸: $20.0 \times 10.0 \times 6.0\text{mm}^3$
- 工作温度: $-55 \sim +85^\circ\text{C}$
- 产品执行标准为 GJB7953-2012

图片:
性能参数: (TA=25°C, 50Ω系统)

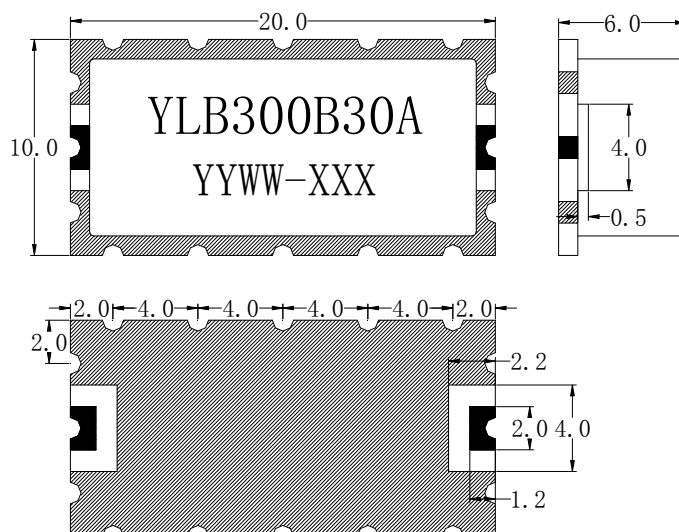
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
中心频率	f_0		300±3			MHz	
-1dB 带宽	BW _{-1dB}		30		35	MHz	
插入损耗	IL	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=300\text{MHz}$		3.0	3.5	dB	
输入带内驻波比	VSWR _i	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=285 \sim 315\text{MHz}$		1.5:1	2.0:1		
输出带内驻波比	VSWR _o			1.5:1	2.0:1		
阻带抑制	SR ₁	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=1 \sim 200\text{MHz}$	50.0			dB	
	SR ₂	$P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=400 \sim 1000\text{MHz}$	50.0			dB	
质量	m				5.0	g	

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
输入射频功率	30.0	dBm	贮存温度	$-55 \sim +100$	°C

封装外形及引脚标识图:



单位: mm 公差: ±0.3mm



字符标志:

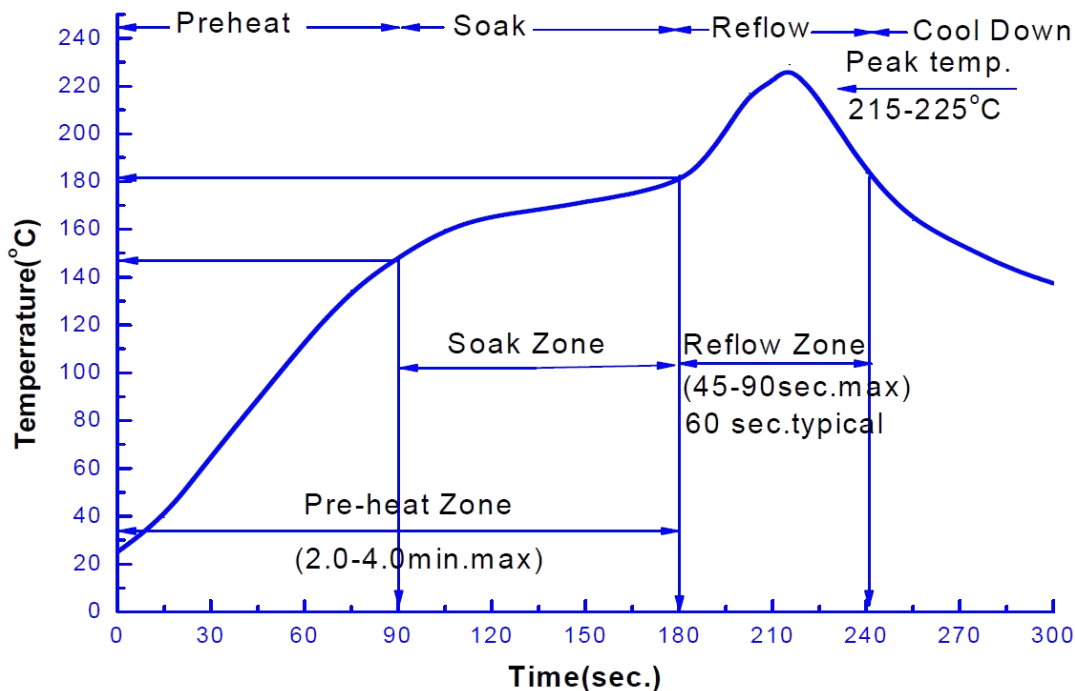
YLB300B30A	产品型号
YYWW	批次号
XXX	序列号

引脚定义:

接口标识	接口说明
	RF IN, RF OUT (可互换)
	GND

产品使用注意事项:

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域）；
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 230℃。

4. 如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。